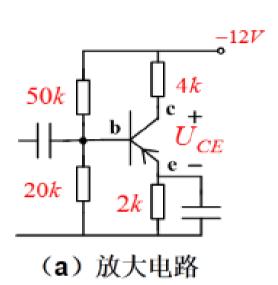
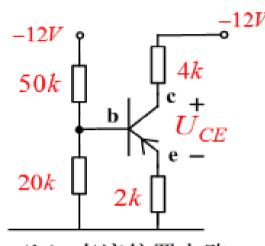
某放大器的直流偏置电路如(b), 且 $|U_{BE}| = 0.7V$, $\beta = 50$, $|U_{CE0}| = 0.3V$ 计算直流工作点, I_{B} , I_{c} , 和 U_{CE}





 $\begin{array}{c|c}
 & & & \\
 & & & \\
\hline
 & & & & \\
\hline
 & & & \\
\hline$

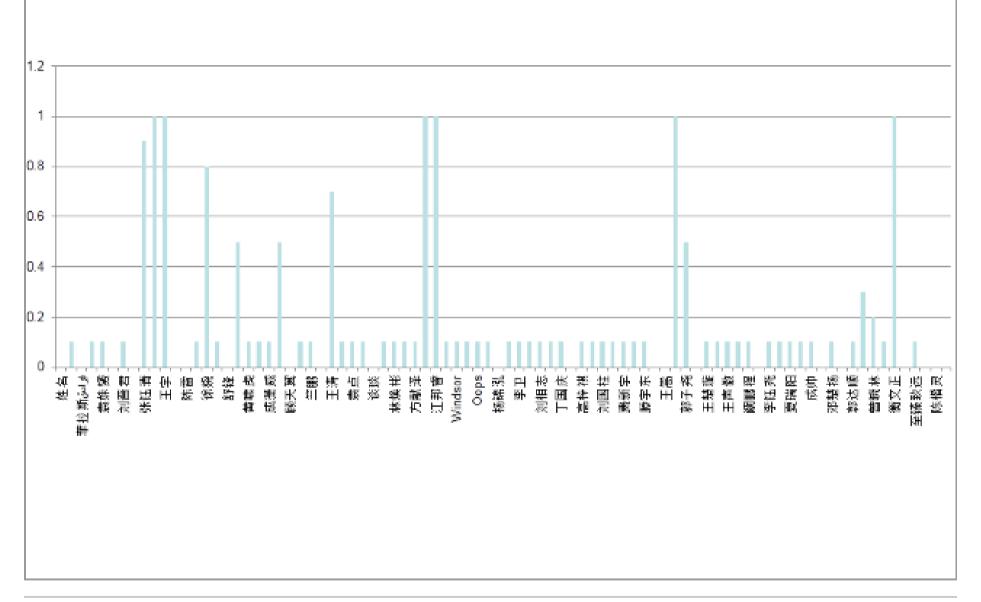
(b) 直流偏置电路

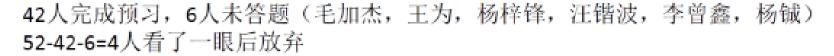
(c) 直流偏置电路的戴维南等效

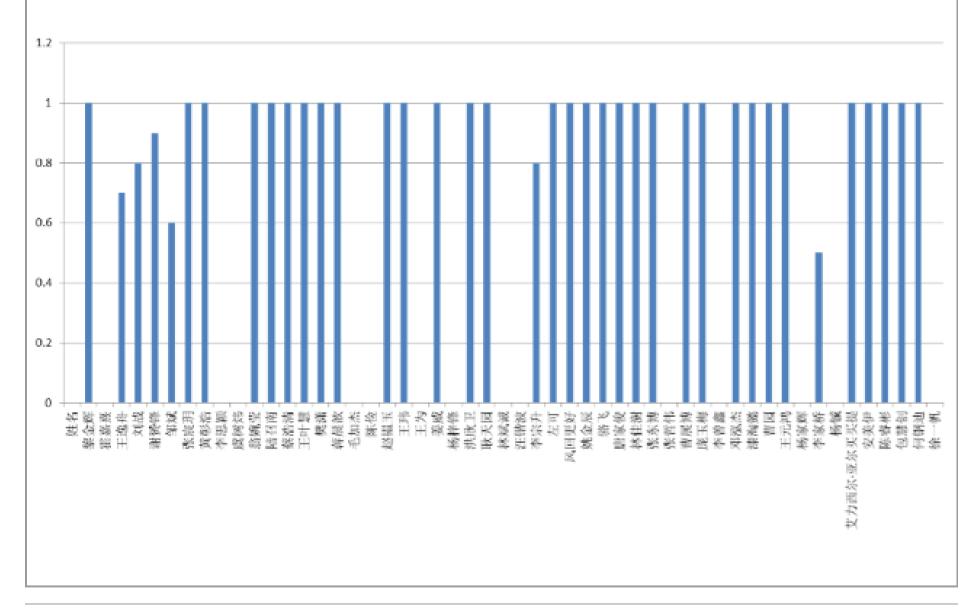
$$\frac{100}{7}kI_B + 0.7 + 2k\beta I_B = \frac{24}{7} \implies I_B = 26.9\mu A \quad 0.0234\text{mA}$$

$$I_C = \beta I_B = 1.345mA \implies u_{CE} = I_C(2k + 4k) - 12 = -3.93V$$
1.17mA -4.96V

47人完成预习, 20人未答题; 85-47-20=18人仅看了一眼?









第3章 电子器件及其电路模型

(semiconductor elements) (circuit analysis)

- 3.0* 半导体基础知识
- 3.1 半导体二极管
- 3.2 晶体三极管
- 3.3 场效应管
- 3.4 集成运算放大器
- 3.5 数字逻辑电路基础

§3.0 律导体基础知识

- 一、本征半导体
- 二、杂质半导体
- 三、PN结的形成及其单向导电性
- 四、PN结的电容效应

一、牵征律导体

1. 什么是准导体? 什么是乖征准导体?

导电性介于导体与绝缘体之间的物质称为半导体。

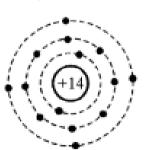
导体一一铁、铝、铜等金属元素等低价元素,其最外层电子在外电场作用下很容易产生定向移动,形成电流。

绝缘体——惰性气体、橡胶等,其原子的最外层电子受原子核的束缚力很强,只有在外电场强到一定程度时才可能导电。

半导体——硅(Si)、锗(Ge),均为四价元素,它们原子的最外层电子受原子核的束缚力介于导体与绝缘体之间。

本征半导体是纯净的晶体结构的半导体。

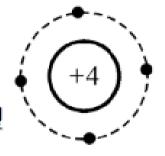
硅原子



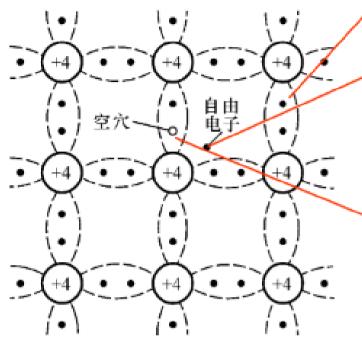
无杂质

稳定的结构

简化原子模型



2、 牵征律导体的结构



共价键

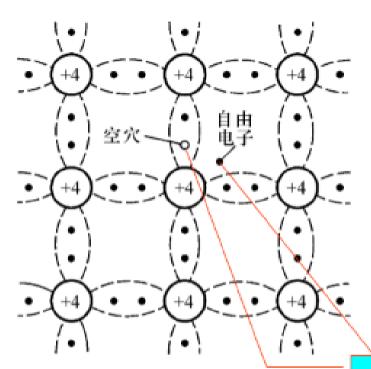
由于热运动,具有足够能量 的价电子挣脱共价键的束缚 而成为自由电子

自由电子的产生使共价键中留有一个空位置,称为空穴

自由电子与空穴相碰同时消失,称为复合。/ 动态平衡

一定温度下,自由电子与空穴对的<u>浓度一定;温度升高,热运动加剧,挣脱共价键的电子增多</u>,自由电子与空穴对的浓度加大。

3、存征华导体中的两种载流子



运载电荷的粒子称为载流子。

外加电场时,带负电的自由电子和带正电的空穴均参与导电, 且运动方向相反。由于载流子数 目很少,故导电性很差。

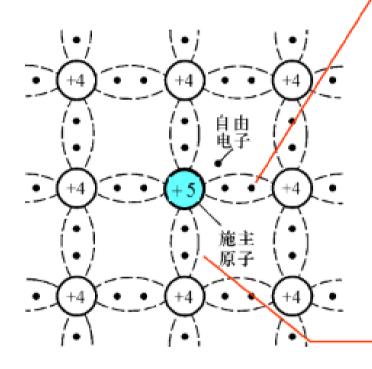
温度升高,热运动加剧,载流子浓度增大,导电性增强。 热力学温度0K时不导电。

两种载流子

为什么要将律导体变成导电性很差的牵征律导体?

二、杂质往导体

1. N型建导体



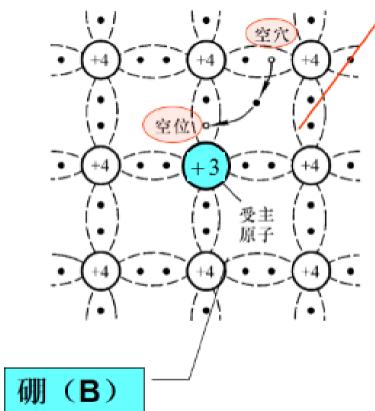
多数载流子

空穴比未加杂质时的数目多 了?少了?为什么?

杂质半导体主要靠多数载流 子导电。掺入杂质越多,多子 浓度越高,导电性越强,实现 导电性可控。

磷 (P)

2. P型律导体



多数载流子

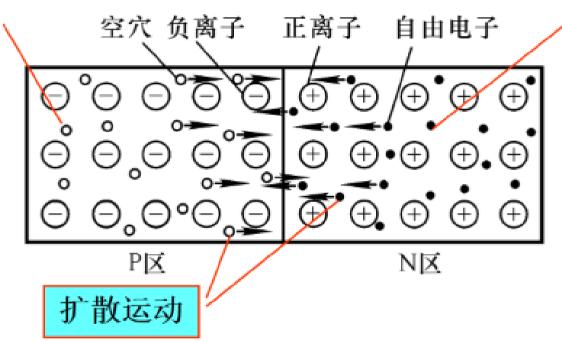
P型半导体主要靠空穴导电, 掺入杂质越多,空穴浓度越高, 导电性越强,

在杂质半导体中,温度变化时,载流子的数目变化吗?少子 与多子变化的数目相同吗?少子 与多子浓度的变化相同吗?

三、PN结的形成及其单向导电性

物质因浓度差而产生的运动称为<mark>扩散运动</mark>。气体、液体、固体均有之。

P区空穴 浓度远高 于N区。

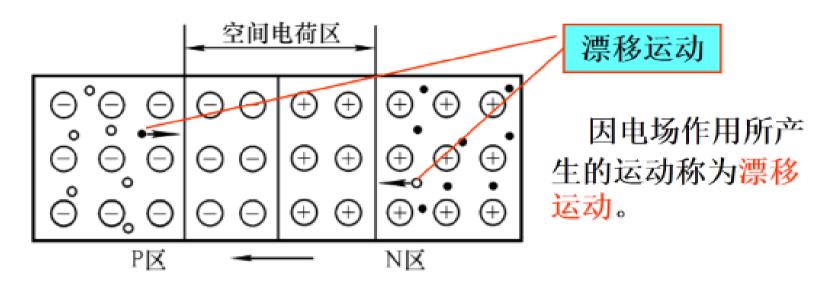


N区自由电 子浓度远高 于P区。

扩散运动使靠近接触面P区的空穴浓度降低、靠近接触面 N区的自由电子浓度降低,产生内电场。

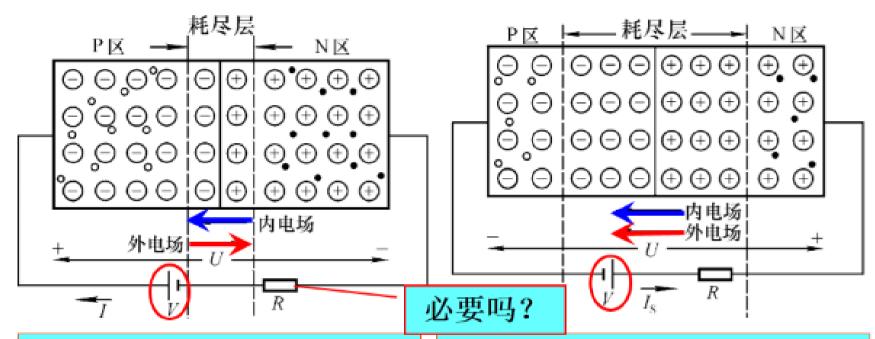
PN结的形成

由于扩散运动使P区与N区的交界面缺少多数载流子,形成内电场,从而阻止扩散运动的进行。内电场使空穴从N区向P区、自由电子从P区向N区运动。



参与扩散运动和漂移运动的载流子数目相同,达到动态 平衡,就形成了PN结。

PN结的单向导电性

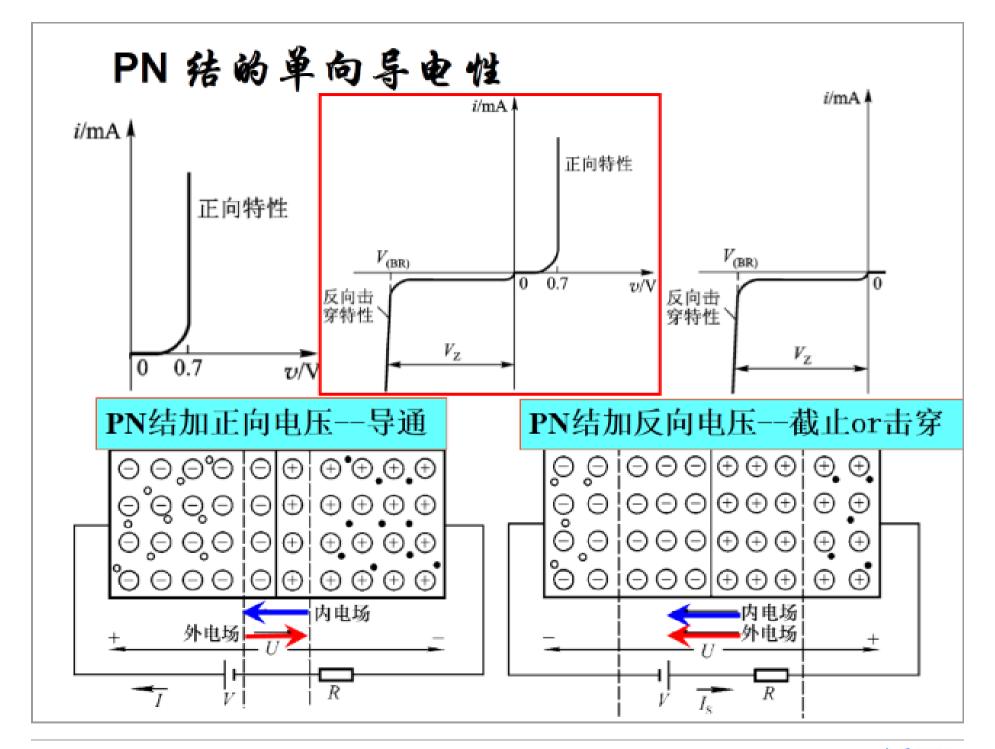


PN结加正向电压导通:

耗尽层变窄,扩散运动加剧,由于外电源的作用,形成扩散电流,PN结处于导通状态。

PN结加反向电压截止:

耗尽层变宽,阻止扩散运动,有利于漂移运动,形成漂移电流。由于电流很小,故可近似认为其截止。



PN结的伏安特性

$$I = I_{S}(e^{V/V_{T}} - 1), V_{T} = kT/q$$

常温下: T = 300K, $V_T = 26 \text{mV}$

> 正向特性

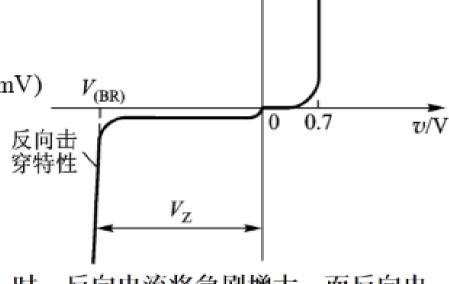
$$I \approx I_{\rm S} e^{V/V_{\rm T}}$$

$$V = V_{\rm T} \ln(I/I_{\rm S}) \approx 60 \lg(I/I_{\rm S}) \,(\text{mV})$$

> 反向特性

截止: *I*≈*I*s

击穿: v≈V_z



i/mA Å

正向特性

- \checkmark 当反偏电压超过反向击穿电压 V_{BR} 时,反向电流将急剧增大,而反向电压值 V_Z 却增加很少;---稳压管工作原理
- ✓ 若对反向电流的增加不加限制, PN 结将迅速烧坏;
- ✓ 雪崩击穿(Avalanche Breakdown); 齐纳击穿(Zener Breakdown);

PN 结的伏安特性 > 温度特性

$$I = I_{S}(e^{V/V_{T}} - 1), V_{T} = kT/q$$

常温下:
$$T = 300K$$
, $V_T = 26 \text{mV}$

▶ 正向温度特性 ---> 左移 <

$$I \approx I_{\rm S} e^{V/V_{\rm T}}$$

少子增加,同样电压下,电流增加

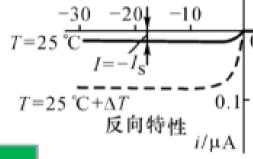
$$V = V_{\rm T} \ln(I/I_{\rm S}) \approx 60 \lg(\overline{I/I_{\rm S}}) \,({\rm mV})$$

反向温度特性

截止: I≈I_S ---> 下移 _{T=25} ℃+ΔT

击穿: v≈V,





少子增加

情况复杂,您若对稳压管有兴趣,请查阅相关资料

i/mA

四、PN结的电容效应

1. 势垒电容

PN结外加电压变化时,空间电荷区的宽度将发生变化,有电荷的积累和释放的过程,与电容的充放电相同,其等效电容称为势垒电容 C_b 。

2. 扩散电容

PN结外加的正向电压变化时,在扩散路程中载流子的浓度及其梯度均有变化,也有电荷的积累和释放的过程,其等效电容称为扩散电容 C_d 。

结电容:
$$C_{\rm j} = C_{\rm b} + C_{\rm d}$$

结电容不是常量!若PN结外加电压频率高到一定程度,则失去单向导电性!

